

IT・エレクトロニクス

Field Intelligence Report

Vol. 51 | 2026.07.20 - 07.26 | 分析記事 86件

半導体後工程 / AI・機械学習 / 量子コンピュータ / 光通信・フォトニクス

マーケットムード

85

/ 100 Accelerating Growth

AI駆動型インフラの構造変革

先端パッケージングと光通信がボトルネックを打破し、次世代コンピューティングを加速する。

先端パッケージング市場規模	AIデータセンター電力消費	AI光ネットワーク市場規模	TSMC Q2純利益
1200億ドル超	20%	1540億ドル	220億ドル
2.18倍	8ポイント増	9倍	77%増
2025年比2031年予測 (S1-03)	2035年米国総電力消費予測 (S2-02)	2026年比2028年予測 (S4-17)	前年同期比 (S2-04)

今週の総括

今週のIT・エレクトロニクス分野は、AIチップの爆発的な需要増が、半導体後工程と光通信・フォトニクス技術に構造的な変革をもたらしていることを明確に示した。TSMCやNvidiaによる巨額投資が先端パッケージング能力の増強と光インターコネクトへの移行を加速させる一方、HBMやABF基板の供給不足が深刻化。AIデータセンターの電力消費増大も課題となる。量子コンピューティングも投資が加速し、長期的視点での技術基盤強化が進む。日本企業は、材料・装置分野での強みを活かし、この変革期におけるサプライチェーンの要衝を確保すべきである。

4サブトピック サマリー

サブトピック	主な動向	勢い	主要プレイヤー
半導体後工程	AIチップ需要増大でCoWoSやHBMの供給ボトルネックが深刻化し、NvidiaはAmkorと15億ドルの契約を締結。TSMCは米アリゾナに1000億ドル追加投資し、先端パッケージング市場は2031年までに1200億ドル超へ倍増すると予測される。日本企業はIbidenが5000億円投資で基板市場をリードする。	↑ 上昇	Nvidia、TSMC、Amkor、Ibiden
AI・機械学習	AIデータセンターの電力消費が2035年までに米国総電力の20%を占める可能性が指摘され、インフラ革新が急務。TSMCはAIチップ需要でQ2利益77%増を達成し、NvidiaとAMDはHBM4搭載次世代GPUで競争を激化。医療分野ではAI診断ソフトウェアのFDA承認が相次ぎ、エンタープライズAIエージェントの普及も進む。	↑ 上昇	Nvidia、AMD、TSMC、Google DeepMind

量子コンピュータ	マイクロソフトがハードウェアレベルでエラー抑制する第2世代トポロジカル量子プロセッサ「Majorana 2」を発表し、スケーラブルなフォールトトレラント量子コンピュータ実現への期待が高まる。2026年前半にはPsiQuantumやDiracへの投資が加速し、量子技術の商用化に向けた動きが活発化する。	↑ 上昇	Microsoft、PsiQuantum、Dirac、NSF
光通信・フォトニクス	AIデータセンターは銅配線から光インターコネクトへ本格移行し、BroadcomとNvidiaがCPOやシリコンフォトニクスを本格採用。ゴールドマン・サックスはAI光ネットワーク市場が2028年までに1540億ドルへ9倍に拡大すると予測。日本企業では住友電気工業がフォトディテクタ特許で業界首位を維持し、タワーセミコンダクターが日本で30億ドル投資を決定する。	↑ 上昇	Nvidia、Broadcom、Marvell Technology、Lightmatter

今週の注目トレンド（全5件）

TR-01 HIGH 分野横断

AIチップ需要と先端パッケージングのボトルネック

AIチップの爆発的需要が先端パッケージング市場を倍増させる一方、CoWoSやHBMの供給不足が深刻化している。

AIチップ、特にGPUとHBMの需要急増により、TSMCのCoWoSやABF基板、HBMそのものの供給が深刻なボトルネックとなっている。Yole Groupは先端パッケージング市場が2031年までに1200億ドル超に倍増すると予測し、NvidiaはTSMCへの依存を減らすためAmkorと15億ドルの契約を締結した。SK HynixやSamsungもHBM生産能力増強に巨額投資を計画するが、供給制約は2027-2028年まで続くと思われる。この状況は、サプライチェーン全体での投資と技術革新を加速させている。

先端パッケージング市場成長率

2.18倍（2025-2031年）

Nvidia-Amkor契約額

15億ドル

SK Hynix/Samsung DRAM投資

5180億ドル

▶ Nvidia ▶ TSMC ▶ SK Hynix ▶ Amkor ▶ Ibiden

参照: S1-01 S1-03 S1-09 S1-13 S1-14

TR-02 HIGH 分野横断

AIデータセンターにおける光インターコネクトへの移行

AIデータセンターは銅配線の物理的限界に直面し、CPOやシリコンフォトニクスを用いた光インターコネクトへの大規模移行を本格化している。

AIデータセンターの電力消費とデータ転送速度の要求増大により、従来の銅配線は物理的限界に達している。Nvidia、Broadcom、Marvell Technologyといった主要企業は、コパッケージドオプティクス（CPO）やシリコンフォトニクス技術を本格採用し、光インターコネクトへの移行を加速。ゴールドマン・サックスはAI光ネットワーク市場が2028年までに1540億ドルへ9倍に急拡大すると予測する。TSMCも光相互接続の次世代ロードマップ「COUPE」を発表し、LightmatterはフォトニックプロセッサでGPU比10倍高速化と電力効率3.5-5倍向上を実証するなど、技術革新が加速している。

AI光ネットワーク市場成長率

9倍（2026-2028年）

Lightmatter高速化

GPU比10倍

Marvell電力削減

80%以上

▶ Nvidia ▶ Broadcom ▶ Marvell Technology ▶ TSMC ▶ Lightmatter

参照: S4-01 S4-05 S4-17 S4-20 S4-23

TR-03 MID 分野横断

グローバル半導体サプライチェーンの再編

米中間の技術覇権争いと各国政府の補助金政策が、半導体製造・パッケージング拠点の地理的分散とサプライチェーンの再編を加速させている。

米国CHIPS ActやEU Chips Act、インド政府のSemicon 2.0といった政策が、半導体製造・パッケージング拠点の国内回帰と地理的分散を促進している。TSMCは米国アリゾナ州に1000億ドル追加投資し、SK Hynixも米国インディアナ州に40億ドルを投じてHBM量産ラインを建設。インドではKaynes SemiconやParas SemiconductorsがOSAT施設を開設し、中国HKCも先進パッケージング・テストラインを新設するなど、各国が自国のサブ

ライチェーン強化に動いている。日本もタワーセミコンダクターが経済産業省支援で30億ドルを投資し、シリコンフォトニクス製造能力を拡張する。

TSMC米国投資総額	インド政府半導体支援	タワーセミコンダクター日本投資
2650億ドル	15.36億ドル	30億ドル

▶ TSMC ▶ SK Hynix ▶ Amkor ▶ タワーセミコンダクター ▶ Kaynes Semicon

参照: S1-02 S1-10 S1-12 S1-27 S4-14

TR-04 MID

AI・機械学習

AIモデルの進化とエンタープライズAIエージェントの普及

大規模マルチモーダルAIモデルが進化し、企業向けAIエージェントがビジネスプロセスの自動化と効率化を加速させている。

Thinking

Machines

Labが9750億パラメータのオープンウェイトマルチモーダルAIモデル「Inkling」を発表し、Moonshot AIも2.8兆パラメータを持つ「Kimi K3」をリリースするなど、AIモデルの大規模化とマルチモーダル化が加速している。同時に、OpenAIの「Presence」やSalesforceの「Agentforce」といったエンタープライズAIエージェントプラットフォームが、複雑なビジネスワークフローの自動化と生産性向上に貢献。医療分野ではAI診断ソフトウェアのFDA承認が相次ぎ、臨床試験へのAI統合も進むなど、AIの実用化が多岐にわたる産業で進展している。

Inklingパラメータ数	Kimi K3パラメータ数	Google DeepMind性能向上
9750億	2.8兆	49% (SWエンジニアリング)

▶ OpenAI ▶ Google DeepMind ▶ Anthropic ▶ Salesforce ▶ HoneyNaps

参照: S2-01 S2-03 S2-07 S2-08 S2-16

TR-05 LOW

量子コンピュータ

量子技術の基礎研究と実用化への投資加速

マイクロソフトがトポロジカル量子プロセッサを発表し、米国NSFが量子材料研究に投資するなど、量子技術の基礎研究と実用化に向けた投資が加速している。

マイクロソフトは、ハードウェアレベルでエラー抑制する第2世代トポロジカル量子プロセッサ「Majorana 2」を発表し、スケーラブルな量子コンピュータ実現への新たな道筋を示した。これは、既存の量子コンピュータが抱えるエラー訂正の課題に対する有望なアプローチである。また、2026年前半にはPsiQuantumやDiraqといったフォトリック量子コンピューティングやシリコン電子スピンキュービット開発企業への投資が加速。米国国立科学財団（NSF）も量子材料研究への投資を強化しており、量子コンピューティング、センシング、ネットワークといった将来技術の基盤構築が進められている。

Majorana世代	Diraq投資額	NSF投資分野
第2世代	2000万豪ドル	量子材料、コンピューティング、センシング、ネットワーク

▶ Microsoft ▶ PsiQuantum ▶ Diraq ▶ NSF

参照: S3-01 S3-02 S4-35

マクロ環境・市場指標

指標	フェーズ	現状	評価	詳細
AIチップ需要	爆発的成長	40%強	HBM不足が「チップフレーション」を加速 (S1-13)	TSMCはAIチップ需要に牽引され、通期売上高成長予測を40%強に引き上げ、設備投資予算も最大640億ドルに拡大した (S2-04)。
先端パッケージング供給	深刻なボトルネック	2027-2028年	CoWoS、ABF基板、T-glassが主要ボトルネック (S1-03)	Yole Groupは先端パッケージング市場が2031年までに1200億ドル超に倍増と予測するが、供給制約は2027年から2028年まで続くと思われる (S1-03)。
AIデータセンター電力消費	急増とインフラ課題	7兆ドル	2035年までに米国電力の20%を消費か (S2-02)	2025年から2030年の間に約7兆ドルがデータセンターの建設とアップグレードに投じられる予定であり、液冷システムなど高度なインフラ技術が導入される (S2-02)。
光通信技術の普及	本格的な移行期	9倍	銅配線から光インターコネクต์へ大規模移行 (S4-01)	ゴールドマン・サックスはAIインフラにおける光ネットワーク市場が2028年までに1540億ドルへ9倍に急拡大すると予測している (S4-17)。

マクロ環境サマリー

AIチップ需要の爆発的増加は、半導体後工程と光通信・フォトニクス市場に前例のない投資と技術革新を促している。先端パッケージングの供給不足は深刻化し、AIデータセンターの電力消費は国家レベルの課題に発展。しかし、シリコンフォトニクスやCPOといった光技術が「銅の壁」を打破し、次世代AIインフラの基盤を構築する。量子コンピューティングも着実に進展し、長期的視点での技術競争が激化する。

市場データ: SOXX（半導体） 週次トレンド

527.01 USD **+1.00%**

先端パッケージング市場規模予測 出典: Yole Group (S1-03)

2025年比2031年で2.18倍に拡大

年	前回(億ドル)	今回(億ドル)	増減
2025	550.0	550.0	+0
2026	600.0	650.0	+50
2027	680.0	750.0	+70
2028	780.0	880.0	+100
2031	1100.0	1200.0	+100

TSMC CoWoS生産能力拡大 → 50%以上増: 2027年まで

TSMCは米アリゾナに1000億ドル追加投資し、台湾の嘉義サイエンスパークにCoWoS工場を2ヶ所追加建設することで、2027年までにCoWoS生産能力を50%以上増加させる計画 (S2-04)。

プレイヤー別行動提案

最終製品メーカーへの行動提案

OEM Nvidia, AMD, Broadcom, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Hesai

NvidiaはAI GPU市場の85%を支配し、次世代Rubinアーキテクチャで推論最適化を詳述。AMDはHBM4搭載Instinct MI455XでNvidiaに対抗し、Microsoftを顧客に獲得した。

リスク

- TSMC CoWoSやHBMの供給不足がAIチップ生産計画を遅延させ、市場シェアを失う
- 自社AIチップ開発競争の激化により、NvidiaやAMDの優位性が低下し、収益性が圧迫される
- AIデータセンターの電力消費増大が運用コストを押し上げ、利益率を低下させる

機会

- AIアクセラレータ向けCPO/シリコンフォトニクス（2028年市場1540億ドル）でNvidia・Broadcomが先行、次世代製品開発で主導権を握る
- エンタープライズAIエージェント市場（グローバルで急成長）でOpenAI・Salesforceが先行、自社業務効率化と新サービス創出
- 医療AIソフトウェア市場（FDA承認加速）でHoneyNaps・VELMENIが先行、診断精度向上と新薬開発加速

今週のアクション

- NvidiaはAmkorとの15億ドル契約に基づき、2028年までに米国での先端パッケージング能力を確保し、サプライチェーンの強靭化を進める
- AMDはMicrosoftとの提携を強化し、HBM4搭載MI455Xの市場投入を加速させ、Nvidiaとの競争優位性を確立する
- Google DeepMindはGemini 3.5 Flash Cyberを政府機関・パートナーに限定提供し、サイバーセキュリティ分野でのAI応用を推進する

□ シナリオ：もしNvidiaが2027年までにCoWoS供給不足を完全に解消できない場合、AMDや自社AIチップ開発を進める大手クラウドプロバイダーが市場シェアを奪う可能性が高い。Nvidiaは今からAmkorやIntelとの協業をさらに深化させ、複数サプライヤー体制を確立すべき。

□ Quick Win：Nvidiaは今週中にAmkorとの共同ロードマップ会議を設定し、2028年までの米国パッケージング能力拡張計画を具体化する。

OSATへの行動提案

OSAT TSMC, UMC, GlobalFoundries, Amkor, ASE, PTI, HKC, Kaynes Semicon, Paras Semiconductors

TSMCはAIチップ需要でQ2利益77%増を達成し、米アリゾナに1000億ドル追加投資。AmkorはNvidiaと15億ドルの契約を締結し、米国での先端パッケージング能力を強化する。

リスク

- CoWoSやハイブリッドボンディング技術の複雑化により、量産立ち上げが遅延し、顧客からの信頼を失う
- 地政学リスクにより、米国やインドでの新規工場建設が遅延し、投資回収が困難になる
- 中国勢（HKC等）が異種チップ統合パッケージングで急速に追いつき、価格競争が激化する

機会

- 先端パッケージング市場（2031年1200億ドル超）でTSMC・Amkorが先行、AIチップ向け高付加価値サービスを拡大
- シリコンフォトニクス製造（UMC・GlobalFoundriesが先行）でAIデータセンター向けCPO部品の量産受託を拡大
- インドOSAT市場（Kaynes Semicon・Paras Semiconductorsが先行）で政府支援を活用し、新規顧客を獲得

今週のアクション

- TSMCは2027年までにCoWoS生産能力を50%以上増加させるため、嘉義サイエンスパークの工場建設を加速し、顧客の需要に応える

- AmkorはNvidiaとの契約に基づき、CHIPS

Act補助金を活用してアリゾナ州の2.5D/3Dパッケージング能力を2028年までに確立する

- UMCはシンガポール12インチファブでのシリコンフォトニクスウェハ量産を拡大し、AI光相互接続市場での存在感を高める

□ シナリオ：もしハイブリッドボンディング技術の量産がSamsungのように2029-2030年まで遅延した場合、AIチップの性能向上が停滞し、顧客が代替技術やサプライヤーを模索する可能性がある。ファウンドリは今から材料メーカーや装置メーカーと緊密に連携し、技術課題の早期解決と量産プロセスの確立を急ぐべき。

□ Quick Win：

TSMCは今週中に主要顧客NvidiaとCoWoS供給ロードマップに関する詳細な協議を行い、今後の生産計画を共有する。

テストメーカーへの行動提案

Test Manufacturer KLA, YieldWerx, HoneyNaps, VELMENI, Median Technologies

KLAはAIプロセッサの複雑化に伴い、プロセス制御システムの重要性を高めている。Straits Researchは先端パッケージング技術が半導体検査市場を2034年までに大きく牽引すると予測する。

■ リスク

- 先端パッケージングの複雑化（異種統合、3D IC）に検査技術が追いつかず、歩留まり低下を招く
- AIチップの多様化と高速化により、既存のテスト装置が対応できず、市場機会を逸する
- AI診断ソフトウェアの倫理的課題（データプライバシー、バイアス）に対応できず、規制当局からの承認が遅れる

■ 機会

- 先端パッケージング検査市場（2034年まで成長）でKLA・YieldWerxが先行、高精度な検査・計測ソリューションを提供
- AI駆動型医療診断ソフトウェア市場（FDA承認加速）でHoneyNaps・VELMENIが先行、睡眠時無呼吸や歯科画像診断を効率化
- 光I/Oのテスト市場（AIワークロードで需要増）でYieldWerxが先行、電氣的・フォトニックテストデータの相関分析を提供

■ 今週のアクション

- KLAはAIプロセッサの複雑化に対応するため、プロセス制御システムのR&D;投資を強化し、欠陥特定精度を向上させる
- YieldWerxはフォトニクスと光I/Oのテスト課題に対応するため、ウェハ・ポート・波長・パッケージ全体で電氣的・フォトニックテストデータを相関させる新ソリューションを開発する
- HoneyNapsはSOMNUM V3.0のFDA承認を活かし、睡眠時無呼吸の自動分類AIソフトウェアの米国市場展開を加速する

□ シナリオ：もしAIチップの異種統合や3Dスタッキングがさらに複雑化し、既存の検査装置では微細な欠陥を特定できなくなった場合、テストメーカーは歩留まり低下の責任を問われ、顧客を失う可能性がある。今からAIを活用した欠陥予測・特定技術や、光学的・非破壊検査技術への投資を強化すべき。

□ Quick Win：KLAは今週中に主要顧客であるTSMCの先端パッケージング部門と、次世代AIチップの検査要件に関する技術協議を開始する。

原材料メーカーへの行動提案

Material Manufacturer Iridium, Ajinomoto, Nittobo, SK Hynix (HBM), JNTC, TOPPAN, NCF

日本のIridiumはAIサーバー向けICパッケージ基板市場で約35%のシェアを占め、5000億円を投資し生産能力を増強。味の素はABFフィルムのIPを独占し、2026年Q3に30%の値上げを通知した。

■ リスク

- ABFフィルムやT-glassなどの主要材料の供給不足が深刻化し、AIチップ生産のボトルネックとなる
- 有機基板の反り問題や信号損失がAIチップの性能限界となり、ガラス基板など新材料への移行が加速する
- 中国勢が半導体材料分野で技術力を向上させ、価格競争が激化し、日本企業の優位性が低下する

■ 機会

- 高性能ICパッケージ基板市場（Ibidenがリード）でAIサーバー向け需要増に対応し、生産能力を増強
- 次世代ガラス基板技術（JNTC・TOPPANが提携）で高密度配線と低損失を実現し、有機基板の限界を打破
- NCF（非導電性フィルム）市場（AIチップ・HBM積層に不可欠）で安定ボンディングと信頼性向上に貢献し、需要を拡大

■ 今週のアクション

- Ibidenは2026年度から2028年度の3年間で5000億円を投じ、AIサーバー向け高性能ICパッケージ基板の生産能力を増強する
- 味の素はABFフィルムの供給不足に対応するため、生産能力増強への投資を検討し、顧客との長期供給契約を締結する
- JNTCとTOPPANはAIチップ向けガラス基板技術の共同開発を加速させ、高密度配線と低損失を実現する次世代材料を市場投入する

□ シナリオ：もしガラス基板技術の技術的障壁が2030年までに解消され、CoPoSのようなガラスインターポーザが主流になった場合、有機基板メーカーは市場を失う可能性がある。有機基板メーカーは今からガラス基板技術へのR&D投資を強化するか、ガラス基板メーカーとの戦略的提携を検討すべき。

□ Quick Win：

味の素は今週中に主要顧客であるIbidenとABFフィルムの長期供給契約および価格改定に関する最終合意を目指す。

商社への行動提案

Trading Company 三菱商事, 住友商事, 丸紅

AIチップ関連の材料・装置・部品の供給網において、グローバルなサプライチェーンの複雑化と地政学リスク増大に対応する役割が拡大している。

■ リスク

- AI関連材料・部品の供給不足や価格高騰により、顧客への安定供給が困難になり、信頼を失う
- 米中間の技術規制強化により、特定の国・地域への輸出入が制限され、ビジネス機会が減少する
- 先端技術の急速な進化に対応できず、顧客ニーズに合致したソリューションを提供できない

■ 機会

- 先端パッケージング材料（ABFフィルム、ガラス基板）のグローバル調達・供給網を強化し、供給不足に対応
- AIデータセンター向け光インターコネクト部品（CPO、シリコンフォトニクス）の新規サプライヤー開拓と販売チャネル構築
- インドや東南アジアなど新興半導体製造拠点への材料・装置供給を拡大し、市場シェアを獲得

■ 今週のアクション

- 今週中にAIチップ向けHBMやABF基板の主要サプライヤー（SK Hynix, 味の素, Ibiden）と供給状況・価格動向に関する情報交換会を実施する
- 3ヶ月以内に米国CHIPS ActやEU Chips Actの補助金対象となる先端パッケージング・光通信関連企業への投資機会を調査し、提携先候補をリストアップする
- Q4 2026までにインドのOSAT施設（Kaynes Semicon, Paras Semiconductors）への材料・装置供給に関する初期交渉を開始する

□ シナリオ：もしAIデータセンターの電力需要増大が予想以上に加速し、液冷システムや高効率電源などのインフラ部品の供給が逼迫した場合、商社は顧客のデータセンター建設・運用計画に大きな影響を与える可能性がある。今から関連部品メーカーとの長期供給契約を締結し、安定供給体制を構築すべき。

□ Quick Win：今週中に主要顧客である日本の製造業向けに、AIチップ関連材料の最新供給状況と価格変動リスクに関する緊急レポートを作成・配布する。

製造設備メーカーへの行動提案

Manufacturing Equipment Manufacturer Besi, Applied Materials, Grand Process Technology, Singulus, SmarAct

BesiはAI、ハイブリッドボンディング、フォトニクス需要で四半期受注が前年同期比128.8%増を記録。Applied MaterialsはPLPでAIアクセラレーター向け新装置市場機会を創出している。

■ リスク

- ハイブリッドボンディングやPLPなどの新技術の量産プロセス確立が遅延し、装置の導入が伸び悩む
- AIチップの設計変更や新材料の導入により、既存装置の互換性問題が発生し、アップグレード需要が減少する
- 中国の半導体装置メーカーが技術力を向上させ、低価格攻勢を仕掛けてくることで、競争が激化する

■ 機会

- ハイブリッドボンディング装置市場（2030年50億ドル超）でBesiがHBM4向けに約30%のシェアを確保し、顧客数を拡大
- パネルレベルパッケージング（PLP）装置市場（Applied Materialsが先行）でAIアクセラレーター向け大型チップパッケージ製造に対応
- 光コンピューティング向けナノポジショニングシステム（SmarActが先行）で次世代フォトニック集積回路（PIC）の特徴評価精度を向上

■ 今週のアクション

- Besiはハイブリッドボンディング技術の顧客導入数を21社からさらに拡大するため、ロジック、メモリ、CPO向けソリューションを強化する
- Applied MaterialsはPLP技術を活用したAIアクセラレーター向け新装置の開発を加速させ、市場投入を早める
- Grand Process

TechnologyはドイツSingulusとの提携を通じて、PLP市場向けエンドツーエンドソリューションの提供を本格化する

□ シナリオ： もしSamsungのようにハイブリッドボンディングの量産開始が2029-2030年まで遅延した場合、装置メーカーは受注の伸び悩みやR&D;投資の回収遅延に直面する可能性がある。今から顧客との共同開発を強化し、量産プロセスの課題を早期に特定・解決するための技術サポート体制を構築すべき。

□ Quick Win： Besiは今週中に主要顧客であるSK

HynixのHBM4開発チームと、ハイブリッドボンディング装置の最適化に関する技術ワークショップを開催する。

インパクトマトリクス (プレイヤー × トレンド)

++ = 大きな追い風 + = 追い風 0 = 中立 - = 逆風 -- = 大きな逆風

プレイヤー	TR-01 HIGH AIチップ需 先端パッケージ	TR-02 HIGH AIデータセ おける光イン	TR-03 MID グローバル半 再編	TR-04 MID AIモデル 進化	TR-05 LOW 量子技術 基礎研究
最終製品メーカー	++	++	+	++	+
OSAT	++	++	++	+	+
テストメーカー	++	++	+	++	+
原材料メーカー	++	++	++	+	+
商社	+	++	++	+	0
製造設備メーカー	++	++	++	+	0

今週のタイムライン (8件)

日付	タグ	ヘッドライン	出典
07.16 Tue	半導体後工程	SK Hynix、米国インディアナ州に40億ドル投資し2028年後半HBM量産へ	Silicon Analysts
07.17 Thu	AI・機械学習	HoneyNaps、睡眠時無呼吸AIソフトウェア「SOMNUM V3.0」でFDA承認取得	Sleep Review
07.18 Fri	光通信・フォトニクス	ソウル大学、光の速度をオンデマンド制御可能なプログラムブルフォトニックチップ開発	ScienceDaily
07.20 Sun	AI・機械学習	TSMC、AIチップ需要でQ2利益77%増220億ドル達成	ServeTheHome
07.22 Tue	量子コンピュータ	マイクロソフト、ハードウェアレベルでエラー抑制する第2世代トポロジカル量子プロセッサ「Majorana 2」発表	AZoQuantum
07.23 Wed	光通信・フォトニクス	ゴールドマン・サックス、AI光ネットワーク市場が2028年までに1540億ドルへ9倍拡大予測	HFCL Insights
07.23 Wed	半導体後工程	Besi、AIとハイブリッドボンディング需要で四半期受注が前年比128.8%増	BE Semiconductor Industries N.V.
07.24 Thu	AI・機械学習	Anthropic Claude、OpusSonnetHaiku音声モードに対応しGmail等アプリ連携強化	Every

注目企業スポットライト

Nvidia [NVDA] ↑ 戦略的提携と投資を加速

NvidiaはAIチップ市場のリーダーとして、TSMCのCoWoS供給不足に対応するためAmkorと15億ドルの戦略的パッケージング契約を締結した。次世代RubinアーキテクチャではAI推論向け最適化を詳述し、メモリボトルネック解消とHBM不足への対応を強化。さらに、Rubin・Blackwell GPU向けに数十億ドルを投じシリコンフォトニクスを導入するなど、AIインフラのボトルネック解消に積極的な投資を行っている。

- Amkorとの契約に基づき、米国での先端パッケージング能力拡張計画を2028年までに具体化する
- 次世代GPU「Rubin」のHBM4搭載計画を加速し、AMDとの競争優位性を維持する
- シリコンフォトニクスへの数十億ドル投資を効率的に実行し、データ転送のボトルネックを解消する

TSMC [TSM] ↑ AIチップ需要で記録的利益と巨額投資

TSMCはAIチップ需要の急増に牽引され、2026年第2四半期に過去最高の220億ドルの純利益を達成し、前年同期比77%増を記録した。通期売上高成長予測を40%強に引き上げ、設備投資予算も最大640億ドルに拡大。米アリゾナ州に1000億ドルの追加投資を決定し、台湾の嘉義サイエンスパークにはCoWoS先端パッケージング工場を2ヶ所追加建設することで、2027年までにCoWoS生産能力を50%以上増加させる計画である。

- 米アリゾナ州での先端半導体製造施設建設を加速し、米国のサプライチェーン強靱化に貢献する
- 嘉義サイエンスパークのCoWoS工場建設を推進し、2027年までの生産能力50%増目標を達成する
- AI向け光相互接続の次世代ロードマップ「COUPE」の開発を加速し、光技術の統合を進める

Lightmatter ↑ フォトニックプロセッサでAI性能を飛躍的に向上

Lightmatter社のフォトニックプロセッサが、AIワークロードを従来のGPUと比較して約10倍高速に実行できることを実証し、電力効率も3.5~5倍向上させた。同社はNvidiaのNVLink Fusionエコシステムに参画し、高性能光接続を展開。2028年の出荷を目指し、TSMCとGlobalFoundriesでコパッケージドオプティクス（CPO）部品の製造を進めており、AIインフラの「銅の壁」を打破する鍵として注目されている。

- TSMCとGlobalFoundriesとの協業を強化し、CPO部品の量産体制を2028年までに確立する
- NvidiaのNVLink Fusionエコシステムでの役割を拡大し、高性能光接続ソリューションの提供を加速する
- フォトニックプロセッサの電力効率と速度優位性を活かし、AIデータセンター市場での採用を拡大する

テクノロジーロードマップ

2026

- ◆ AIデータセンター向け800G/1.6T光モジュール量産本格化 (S4-21)
- ◆ EU AI Actの生成AI透明性義務施行 (S2-06)
- ◆ TSMCの1.6 Tb/s光エンジン搭載製品登場見込み (S4-23)
- ◆ 味の素ABFフィルム30%値上げ通知 (S1-26)

2027

- ◆ TSMC CoWoS生産能力50%以上増加目標 (S2-04)
- ◆ タワーセミコンダクター日本工場300mmシリコンフォトニクス製造対応 (S4-14)
- ◆ SK Hynix清州P&T7;工場ウェーハテストライン設置 (S1-16)
- ◆ EU AI Act高リスクAIシステム遵守期限開始 (S2-06)

2028

- ◆ AI光ネットワーク市場1540億ドル規模へ拡大予測 (S4-17)

-
- ◆ Amkorアリゾナ先端パッケージング施設生産開始 (S1-01)
 - ◆ SK Hynix米国インディアナ州HBM量産開始 (S1-27)
 - ◆ SK Hynix清州P&T7;工場ウェーハレベルパッケージングライン建設 (S1-16)

2029

- ◆ SamsungハイブリッドボンディングHBM量産開始 (S1-07)
- ◆ AIデータセンター電力消費が米国総電力の12%に到達予測 (S2-02)

2030

- ◆ ハイブリッドボンディング市場50億ドル以上に成長予測 (S1-06)
- ◆ AIデータセンター建設・アップグレードに7兆ドル投資完了 (S2-02)
- ◆ ガラスインターポーザ技術的障壁解消見込み (S1-20)

参考文献一覧（全86件）

ID	タイトル	出典	日付	地域	サブトピック
S1-01	01_AIチップのパッケージングボトルネック深刻化：NVIDIA、TSMCのCoWoS不足でIntel E	The Economy	2026年07月16日	日本	半導体後工程
S1-02	02_TSMC、米国アリゾナ州に1000億ドルの追加投資を決定、総額2650億ドルで先端半導体製造を強化	Supply Chain Dive	2026年07月23日	米国	半導体後工程
S1-03	03_Yole Group、先端パッケージング市場が2031年までに1200億ドル超に倍増と予測、AI・H	Yole Group (via advancedpackaging.news)	2026年07月23日	フランス	半導体後工程
S1-04	04_中国HKC、紹興に40億人民元を投じ先進半導体パッケージング・テストラインを新設、異種チップ統合を推	TrendForce	2026年07月24日	中国	半導体後工程
S1-05	05_台湾Grand Process Technology、ドイツSingulusと提携しパネルレベルパッ	Taiwan News	2026年07月22日	台湾	半導体後工程
S1-06	06_Besi Semiconductor、AIとハイブリッドボンディング需要で四半期受注が倍増、顧客数も	WHTC (Reuters)	2026年07月23日	オランダ	半導体後工程
S1-07	07_Samsung、ハイブリッドボンディングHBMの量産開始を2029-2030年に延期、技術課題とN	TrendForce	2026年07月22日	韓国	半導体後工程
S1-08	08_Powertech TechnologyとBroadcom、シンガポールに4億ドル投資しAI ASI	DigiTimes	2026年07月17日	台湾	半導体後工程
S1-09	09_NvidiaとAmkorが15億ドルの先進パッケージング契約を締結、TSMC CoWoSのボトルネッ	TradingKey	2026年07月24日	米国	半導体後工程
S1-10	10_インド中核州が₹6,200 croreを投じParas SemiconductorsとのOSAT施設	ET Government	2026年07月22日	インド	半導体後工程
S1-11	11_韓国JNTECと日本TOPPAN、AIチップ向けガラス基板技術で提携を発表、有機基板の限界を打破し次世	Tai (via Semiconductor News)	2026年07月18日	韓国	半導体後工程
S1-12	12_インドの半導体エコシステムが急拡大、政府が₹1.275兆を投じSemicon 2.0を推進、ATMP	Asia Briefing	2026年07月16日	インド	半導体後工程
S1-13	13_HBM不足が「チップフレーション」を加速、TrendForceはAI需要による新常態を予測	The Korea Economic Daily	2026年07月16日	韓国	半導体後工程
S1-14	14_韓国半導体大手SamsungとSK hynix、DRAM生産倍増へ5180億ドルの巨額投資を計画、A	CoinDesk	2026年07月19日	韓国	半導体後工程
S1-15	15_モディ首相、Kaynes Semiconのインド・グジャラート州OSAT施設を開設、年産23億チップ	YouTube (ANI News)	2026年07月16日	インド	半導体後工程
S1-16	16_SK Hynix、清州P&T7;工場に7.1兆ウォンの追加投資を再承認、HBMとAIメモリ向け先進パッ	The Elec	2026年07月22日	韓国	半導体後工程
S1-17	17_Co-Packaged Optics (CPO) 需要がAIチップサプライチェーンを再構築、高帯域幅と低	Astute Group	2026年07月20日	英国	半導体後工程

ID	タイトル	出典	日付	地域	サブトピック
S1-18	18_HBM4の競争焦点が冷却技術に移行、ハイブリッドボンディング導入の遅れとNvidia次世代GPUの動	DigiTimes	2026年07月17日	台湾	半導体後工程
S1-19	19_AMDのHelios AIラック、HBM4でNVIDIAに対抗しMicrosoftを顧客に獲得、2n	TrendForce	2026年07月21日	台湾	半導体後工程
S1-20	20_先進パッケージ基板市場が過熱：Ibidenが5000億円投資でリード、Samsung Electro	MK	2026年07月17日	日本	半導体後工程
S1-21	21_Straits Research 先端パッケージング技術が半導体検査市場を牽引、2034年までに大き	Straits Research	2026年07月23日	米国	半導体後工程
S1-22	22_NVIDIA、Amkorと15億ドルの戦略的提携で米国AIチップ先端パッケージング能力を2028年ま	ETElectronics	2026年07月23日	米国	半導体後工程
S1-23	23_BESI、AI関連パッケージングとハイブリッドボンディング需要で受注が前年比128.8%増、四半期記	BE Semiconductor Industries N.V.	2026年07月23日	オランダ	半導体後工程
S1-24	24_PowertechとBroadcom、シンガポールで4億ドル合併事業を設立しAI ASIC向けFOP	Taipei Times	2026年07月17日	台湾	半導体後工程
S1-25	25_TYlsemi、4300万ドルのシード資金調達でチップレット設計のリスク低減、フルスタックブラットフ	Tom's Hardware	2026年07月16日	米国	半導体後工程
S1-26	26_味の素、ABFフィルム30%値上げでAIチップ向け高性能基板市場の供給不足が深刻化、Ibidenが5	ZERO - note	2026年07月21日	日本	半導体後工程
S1-27	27_SK hynix、米国インディアナ州に40億ドル投資し2028年後半HBM量産へ、CHIPS法活用で	Silicon Analysts	2026年07月16日	米国	半導体後工程
S1-28	28_Fraunhofer、EU Chips Actの下で先端パッケージングとヘテロジニアスインテグレーション	Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF	2026年07月21日	ドイツ	半導体後工程
S1-29	29_Applied Materials、PLPでAIアクセラレーター向け新装置機会、KLAは複雑化するA	TIKR.com	2026年07月18日	米国	半導体後工程
S1-30	30_NCF、AIチップ・HBM積層向け先端パッケージングの不可欠な材料へ進化、安定ボンディングと信頼性向	LP Information Data	2026年07月20日	グローバル	半導体後工程
S2-01	01_臨床試験にAIを統合することで効率が向上し、開発が加速、倫理的課題への対応も重要	Krishna School Of Pharmacy & Research (via IJPS Journal)	2026年07月20日	インド	AI・機械学習
S2-02	02_AIデータセンター、2035年までに米国電力の20%を消費か：インフラ革新と電力需要の急増	Programs.com	2026年07月21日	米国	AI・機械学習
S2-03	03_HoneyNaps、睡眠時無呼吸のサブタイプ自動分類AIソフトウェア「SOMNUM V3.0」でFD	Sleep Review	2026年07月17日	米国	AI・機械学習

ID	タイトル	出典	日付	地域	サブトピック
S2-04	04_TSMC、AIチップ需要でQ2利益77%増220億ドル達成、米アリゾナに1,000億ドル追加投資、C	ServeTheHome	2026年07月20日	台湾	AI・機械学習
S2-05	05_Nvidia、AI推論向けRubinアーキテクチャ最適化を詳述：メモリボトルネック解消とHBM不足へ	Tom's Hardware	2026年07月21日	米国	AI・機械学習
S2-06	06_EU AI Act、高リスクAIシステムに最長2028年8月まで猶予期間を延長、生成AIの出力とディ	Eversheds Sutherland	2026年07月23日	EU	AI・機械学習
S2-07	07_Thinking Machines Lab、9750億パラメータのオープンウェイトマルチモーダルAI	BigGo Finance	2026年07月18日	米国	AI・機械学習
S2-08	08_Google DeepMind、ソフトウェア脆弱性発見とパッチ適用に特化しベンチマークでDeepSW	Security Affairs	2026年07月23日	米国	AI・機械学習
S2-09	09_Moonshot AI、100万トークンのコンテキストウィンドウと2.8兆パラメータを持つマルチモー	Build Fast with AI	2026年07月17日	中国	AI・機械学習
S2-10	10_Google DeepMind、汎用ワールドAIモデル「Genie 3」でAGIへの道筋を強化：3D	Wisdomplexus	2026年07月17日	米国	AI・機械学習
S2-11	11_VELMENI、AI搭載3D CBCT歯科画像ソフトウェア「VELMENI for DENTISTS	PR Newswire	2026年07月23日	米国	AI・機械学習
S2-12	12_生成AIサーバー市場規模予測レポート：GPU不足がサプライチェーンを逼迫、NVIDIA、SK Hyn	Precedence Research	2026年07月21日	グローバル	AI・機械学習
S2-13	13_AMD、Nvidia Rubin GPUを上回るHBM4メモリ432GBを搭載したInstinct	Tom's Hardware	2026年07月23日	米国	AI・機械学習
S2-14	14_Median Technologies、AI駆動型肺がんスクリーニング・早期診断支援ソフトウェア「e	Business Wire	2026年07月22日	フランス	AI・機械学習
S2-15	15_Anthropic Claude、OpusSonnetHaiku音声モードに対応しGmail等アプリ	Every	2026年07月24日	米国	AI・機械学習
S2-16	16_エンタープライズAIエージェントがビジネスプロセスを自動化：Salesforce Agentforc	AI Agent Hub	2026年07月23日	グローバル	AI・機械学習
S2-17	17_オーストラリア政府、AI国家規制フレームワーク導入を延期しつつ「AI局」設立、クリエイターの著作権保	Science Media Centre	2026年07月21日	オーストラリア	AI・機械学習
S2-18	18_OpenAI、高価値業務向けエンタープライズAIエージェントプラットフォーム「Presence」を発	OpenAI	2026年07月22日	米国	AI・機械学習
S3-01	01_マイクロソフト、ハードウェアレベルでエラー抑制する第2世代トポロジカル量子プロセッサ「Majoran	AZoQuantum	2026年07月22日	米国	量子コンピュータ
S3-02	02_量子コンピューティング市場、2026年前半に投資加速：PsiQuantumとDiraqが注目株に	Landbase	2026年07月21日	米国	量子コンピュータ

ID	タイトル	出典	日付	地域	サブトピック
S4-01	01_AIデータセンター、銅配線から光インターコネクトへ本格移行 BroadcomとNvidiaがCPO、	MLQ News	2026年07月23日	米国	光通信・フォトニクス
S4-02	02_DataM Intelligenceが「フォトニクス・エレクトロニクス融合技術市場（2026-203	openPR.com (DataM Intelligence)	2026年07月19日	米国	光通信・フォトニクス
S4-03	03_Global Market Insightsが「AIチップ向け光I/O市場（2026-2035年）」レ	Global Market Insights Inc.	2026年07月23日	米国	光通信・フォトニクス
S4-04	04_AIデータセンターの限界突破へ シリコンフォトニクスが800G1.6TトランシーバーとCPOで主役に	MarketWise	2026年07月22日	米国	光通信・フォトニクス
S4-05	05_NvidiaとBroadcomがCPOシリコンフォトニクスを本格採用、量産体制へ移行しサプライチェーン	BigGo Finance	2026年07月24日	米国	光通信・フォトニクス
S4-06	06_AI ETF「AGIX」が非公開のAyar Labsを追加、KraneSharesがフォトニクスET	ETF Stream (via KraneShares)	2026年07月21日	米国	光通信・フォトニクス
S4-07	07_ノキア、AIワークロード向けに高速・高効率な新光ネットワークソリューションを発表	Precedence Research	2026年07月16日	米国	光通信・フォトニクス
S4-08	08_超低電圧薄膜二オプ酸リチウム変調器、224 Gbits PAM-4信号をサポートし小型光チップに貢献	ResearchGate	2026年07月16日	不明	光通信・フォトニクス
S4-09	09_住友電気工業、光トランシーバー用フォトディテクタ特許で85件を保有し業界首位に	Patsnap Insights Team	2026年07月22日	シンガポール	光通信・フォトニクス
S4-10	10_小型集積フォトニクス光周波数コム、移動環境下で堅牢なピコ秒級タイミングネットワークを実現	ResearchGate	2026年07月17日	不明	光通信・フォトニクス
S4-11	11_富士通、1Finity、中華電信が台湾でオールフォトニクスネットワークと量子技術開発を推進する2年間	Fujitsu Global Newsroom	2026年07月22日	日本	光通信・フォトニクス
S4-12	12_シンガポールのSILITH Technology、UMC シンガポール12インチファブから初の量産シリ	Semiconductor Today	2026年07月22日	シンガポール	光通信・フォトニクス
S4-13	13_MITが可動部品なしで広視野を実現する新型LiDARチップを開発、自動運転車に革新をもたらす可能性	ScienceDaily	2026年07月22日	米国	光通信・フォトニクス
S4-14	14_タワーセミコンダクター、経済産業省支援で日本に30億ドル投資し300mmシリコンフォトニクス製造へ	Tom's Hardware	2026年07月16日	日本	光通信・フォトニクス
S4-15	15_ソウル大学の研究チーム、光の速度をオンデマンドで制御可能なプログラマブルフォトニックチップを開発	ScienceDaily	2026年07月18日	韓国	光通信・フォトニクス
S4-16	16_テルアビブ大学を含む国際チーム、光を74フェムト秒で制御する極薄メタサーフェス開発で新記録樹立	Ynet News	2026年07月22日	イスラエル	光通信・フォトニクス
S4-17	17_ゴールドマン・サックス、AIデータセンターの光ネットワーク市場が2028年までに1540億ドルへ9倍	HFCL Insights	2026年07月23日	米国	光通信・フォトニクス

ID	タイトル	出典	日付	地域	サブトピック
S4-18	18_STマイクロエレクトロニクス、AIデータセンター向けPIC100シリコンフォトニクスを300mmウェ	EE Times	2026年07月16日	国際	光通信・フォトニクス
S4-19	19_Hesai、WAIC 2026で3D空間認識とカラーセンシングを統合した「Kosmo空間インテリジェ	Hesai Technology	2026年07月20日	中国	光通信・フォトニクス
S4-20	20_Lightmatterのフォトニックプロセッサ、AIワークロードをGPU比で約10倍高速化し電力効率	Daily Maverick	2026年07月19日	米国	光通信・フォトニクス
S4-21	21_光通信企業の半期業績予想が好調、800G・1.6T光モジュールがAIデータセンターで量産段階へ	36kr	2026年07月23日	中国	光通信・フォトニクス
S4-22	22_YieldWerxが2026年のフォトニクスと光IOの主要トレンドと課題を分析：AIワークロードでイ	yieldWerx	2026年07月24日	米国	光通信・フォトニクス
S4-23	23_TSMCがAI向け光相互接続の次世代ロードマップ「COUPE」を発表、2026年には1.6 Tbs光	Tech Investments	2026年07月19日	台湾	光通信・フォトニクス
S4-24	24_光トランシーバのフォトニック集積化特許、Marvell Asiaが首位を維持しTSMC・Intelな	Patsnap	2026年07月22日	国際	光通信・フォトニクス
S4-25	25_ドイツSmarAct社、Akhetonics社と協業しナノポジショニングシステムで光コンピューティン	Physics World	2026年07月23日	ドイツ	光通信・フォトニクス
S4-26	26_AIインフラが数十億ドルの新規投資を引き寄せる中、フォトニクスが帯域幅・低遅延・電力効率でブレークス	International Banker	2026年07月23日	国際	光通信・フォトニクス
S4-27	27_Lightmatter社、AI業界がフォトニック相互接続の規模拡大に注力しデータ転送速度100倍、電	Tom's Hardware	2026年07月23日	米国	光通信・フォトニクス
S4-28	28_AI光学チップ技術が次世代コンピューティングアプリケーションで強力な成長を牽引	Semiconductor-knowledge-hub	2026年07月20日	国際	光通信・フォトニクス
S4-29	29_Nvidia、Rubin・Blackwell GPU向けに数十億ドルを投じシリコンフォトニクスを導入	Medium	2026年07月19日	米国	光通信・フォトニクス
S4-30	30_イオンビーム折り紙技術、3D光チップ製造を数秒に短縮し従来比100倍以上の高速化を実現	Intelligent Living	2026年07月20日	国際	光通信・フォトニクス
S4-31	31_UMCが初のシリコンフォトニクスウェハを出荷、Tower Semiconductorは日本で30億ド	PhotonCap	2026年07月16日	国際	光通信・フォトニクス
S4-32	32_ケンブリッジのスピンオフ企業CamGraPhIC、グラフェンベースフォトニックトランシーバでAI相互	Cambridge Review	2026年07月21日	英国	光通信・フォトニクス
S4-33	33_Marvell Technology、Celestial AI買収でオンチップ光専門知識を強化し、1	Kavout	2026年07月22日	米国	光通信・フォトニクス
S4-34	34_MarvellのCelestial AI買収で消費電力80%以上削減、GlobalFoundries	NAI 500	2026年07月21日	米国	光通信・フォトニクス
S4-35	35_米国国立科学財団（NSF）、量子コンピューティング・センシング・ネットワークに向けた量子材料研究に投	U.S. National Science Foundation	2026年07月21日	米国	光通信・フォトニクス

ID	タイトル	出典	日付	地域	サブトピック
S4-36	36_高解像度ダイレクトToF LiDARがエッジAIに空間インテリジェンスをもたらし、ロボティクス・AR	Laser Focus World	2026年07月20日	国際	光通信・フォトンクス

編集後記

AI駆動型インフラの変革期、日本企業は材料・装置で勝機を掴む。

AIチップの爆発的な需要は、半導体後工程と光通信・フォトンクスという二つの技術領域に未曾有の構造変革をもたらしている。CoWoSやHBMの供給不足、ABF基板の値上げといったボトルネックが顕在化する一方で、シリコンフォトンクスやコパッケージドオブティクス（CPO）といった光技術が、AIデータセンターの「銅の壁」を打破する中核技術として急速に普及。この変革期において、日本企業はIbidenや住友電気工業が示すように、高性能材料や光デバイス、製造装置といった分野で依然として高い技術力と市場シェアを保持している。

しかし、グローバルなサプライチェーン再編の動きは加速しており、米国やインド、中国が巨額の政府支援を背景に自国の製造・パッケージング能力を強化している。この地政学的な変化は、日本企業にとって新たな市場機会と同時に、競争激化のリスクも意味する。特に、AIデータセンターの電力消費増大という課題は、高効率な冷却技術や省電力な光インターコネクトの需要をさらに押し上げ、日本が強みを持つ精密加工や材料技術の重要性を高めるだろう。

量子コンピューティングの進展はまだ萌芽的だが、長期的にはAIと融合し、現在のコンピューティングパラダイムを根本から変える可能性を秘めている。日本企業は、短期的なAIインフラ投資の波に乗るだけでなく、中長期的な視点で量子技術や次世代材料の研究開発にも投資し、将来の技術覇権を確保するための布石を打つべきである。この変革期を乗り越えるには、技術革新への迅速な対応と、グローバルなパートナーシップ戦略が不可欠となる。

日本の製造業や商社は、自社の強みを再認識し、AI駆動型インフラの進化に合わせた戦略を再構築する必要がある。材料・装置分野での技術的優位性を維持しつつ、新たな市場ニーズに対応するソリューション開発、そして国際的なサプライチェーンにおける自社の位置付けを強化することが、今後の成長の鍵となるだろう。

- ◆ AIチップの供給ボトルネックが続く中で、日本企業はどのようにしてサプライチェーンの安定化と自社の競争力強化を両立させるべきか？
- ◆ AIデータセンターの電力消費増大という課題に対し、日本の高効率冷却技術や省電力光デバイスメーカーは、どのような戦略でグローバル市場での存在感を高めるべきか？
- ◆ 量子コンピューティングの実用化が視野に入らる中で、日本の製造業はどのような分野で先行投資を行い、将来のAI・コンピューティング市場での優位性を確保すべきか？

Troy Technical Weekly 編集部 チーフアナリスト

次号予告 Vol. 52 2026年8月5日 月曜 06:00 JST 特集: 次世代AIモデルの倫理的課題と規制動向